

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-010

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 关于签署投资协议书的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司与嘉兴市南湖高新技术产业园区管理委员会正式签署《投资协议书》，在嘉兴市南湖高新技术产业园区投资“年产96万片12英寸硅外延片项目”，项目计划总投资12.3亿元。
- 特别风险提示：本次签署《投资协议书》约定的投资项目尚处于初期阶段，项目实施情况存在变动可能性，项目投资金额、投资周期、建设周期等以未来实际情况发生为准。后续协议各方向项目公司实际增资情况具有不确定性，公司将根据实际增资情况另行审议、评估、披露。外延片项目实施完成后可能面临因市场竞争加剧、行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日与嘉兴市南湖高新技术产业园区管理委员会正式签署《年产96万片12英寸硅外延片生产项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”），公司将在嘉兴市南湖高新技术产业园区投资“年产96万片12英寸硅外延片项目”（以下简称“外延片项目”）。外延片项目计划总投资12.3亿元，其中固定资产投资11.2亿元。

具体内容详见公司于2025年2月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体披露的《关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-008）

二、协议的主要内容

甲方：嘉兴南湖高新技术产业园区管理委员会

社会统一信用代码：113304020025505751

乙方：杭州立昂微电子股份有限公司

社会统一信用代码：91330100736871634P

1. 项目约定

乙方在甲方辖区内投资外延片生产项目，与市、区及甲方合资注册成立新公司（以下简称“项目公司”），注册资金 5 亿元。先期由乙方成立全资子公司，注册资金 1 亿元，剩余注册资金各方后续陆续增资到位。该项目计划总投资 12.3 亿元，其中固定资产投资 11.2 亿元。预计项目全部建成达产后形成年产 96 万片 12 英寸硅外延片的生产能力。项目在金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴金瑞泓”）厂房内实施。

2. 具体扶持办法

2.1 由乙方与市、区及南湖高新区产业基金或国资平台出资成立新项目公司，注册资本 5 亿元，其中乙方出资 75%，市、区及南湖高新区产业基金或国资平台出资 25%。具体投资细则及股权投资协议另行商议签订。（2.2-2.8 条为补助、保障、政策扶持办法等，具体内容省略）

3. 双方义务

3.1 甲方义务

3.1.1 甲方根据乙方委托，为乙方提供工商注册、项目报批（包括环评、能评、消防、安全生产等）等全程服务，为乙方运营提供良好营商环境。

3.1.2 甲方为扶持乙方做大做强，及时向乙方介绍并全力协助乙方争取上级部门各项政策扶持。

3.1.3 甲方应当按本协议约定落实各项优惠政策并支付对应的补助资金。

3.1.4 乙方及项目公司因企业发展需要扩大办公生产用房的，在同等条件下，甲方应当优先满足。

3.1.5 若乙方或项目公司计划进一步提升产能，甲方给予优先保障。本协议中约定的生产设备补助、研发投入补助及人才类相关政策可继续享受，其他相关政策细节可根据实际情况另行商定。

3.2 乙方义务

3.2.1 乙方承诺依法建设、合法经营，服从和配合甲方及相关职能部门的管理。

3.2.2 乙方负责提供项目的可行性研究报告、环境影响评估报告、节能评估报告等材料，并积极配合甲方提供相关审批所需材料。

3.2.3 乙方承诺项目在生产过程中产生的废水、废气、危险废弃物的处置须符合国家、省、市相关的环保法律法规规定及本项目环评报告和批复要求。

3.2.4 自乙方及项目公司在甲方辖区内落户之日起，项目实施企业如拟增资扩股，甲方享

有第一时间知情之权利且甲方或其指定的关联第三方相较其他社会资本（乙方原有股东除外）享有优先或同等认购之权利。

三、对上市公司的影响

外延片项目系公司在控股子公司嘉兴金瑞泓现有 15 万片/月的 12 英寸硅抛光片产能基础上进一步延伸外延片产能。目前嘉兴金瑞泓高性能集成电路客户的硅片生长外延需求需依赖公司控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司的外延产能，本次签署《投资协议书》约定的外延片项目投产后可更加快速的响应高性能集成电路客户对于硅片生长外延的需求，减少物流运输成本，更好的控制产品质量，有利于进一步提高公司产品的竞争力。外延片项目建成后公司衢州、嘉兴两大 12 英寸硅片生产基地将均具有从单晶硅到硅外延片的完整生产能力。有利于提升上市公司持续经营能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司全体股东的利益。

外延片项目投资的资金来源主要为自有资金和自筹资金，建设周期约为 5-8 年，项目投资和建设进度具有不确定性，公司将根据市场情况及时调整项目投资进度和建设进度。由于本项目建设尚需一定的时间周期，本次签署的《投资协议书》短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，预计对公司 2025 年度的经营业绩不会构成重大影响。

四、特别风险提示

本次签署《投资协议书》约定的投资项目尚处于初期阶段，项目实施情况存在变动可能性，项目投资金额、投资周期、建设周期等以未来实际情况发生为准。后续协议各方向项目公司实际增资情况具有不确定性，公司将根据实际增资情况另行审议、评估、披露。外延片项目实施完成后可能面临因市场竞争加剧、行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 22 日